

請求の範囲

- [請求項1] 熱硬化性樹脂、層状ケイ酸塩化合物および熱可塑性樹脂を含有し、素子を封止するための封止用樹脂シートであり、
前記熱可塑性樹脂の質量 α に対する前記層状ケイ酸塩化合物の質量 A の比 (A/α) が、0.3以上、2.0以下であることを特徴とする、封止用樹脂シート。
- [請求項2] 前記層状ケイ酸塩化合物の含有割合 B が、3質量%以上、7質量%以下であることを特徴とする、請求項1に記載の封止用樹脂シート。
- [請求項3] 前記熱可塑性樹脂が、 -30°C 以上、 -10°C 以下のガラス転移温度 T_g を有することを特徴とする、請求項1に記載の封止用樹脂シート。
- [請求項4] 前記熱可塑性樹脂が、 -30°C 以上、 -10°C 以下のガラス転移温度 T_g を有することを特徴とする、請求項2に記載の封止用樹脂シート。
- [請求項5] 前記層状ケイ酸塩化合物は、表面が有機成分により変性されていることを特徴とする、
請求項1に記載の封止用樹脂シート。
- [請求項6] 前記層状ケイ酸塩化合物は、表面が有機成分により変性されていることを特徴とする、
請求項2に記載の封止用樹脂シート。
- [請求項7] 前記層状ケイ酸塩化合物は、表面が有機成分により変性されていることを特徴とする、
請求項3に記載の封止用樹脂シート。
- [請求項8] 前記層状ケイ酸塩化合物は、表面が有機成分により変性されていることを特徴とする、
請求項4に記載の封止用樹脂シート。